



TWSE STOCK CODE 1560



中砂公司4Q24法說會
@台新證券
2025/2/26



中砂投資人服務信箱
ir@kinik.com.tw

WWW.KINIK.COM.TW

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，係本公司基於公司資料及現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於原物料成本增加、市場需求，各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不保證本簡報資料之正確性，且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。

- **Welcome**

William Lee 李偉彰, 鑽石事業部總經理 / 發言人
Tony Pai 白景中, 副總經理 / 代理發言人
- 公司簡介
- 2024 第四季&全年營運概況
- 近期重要事件摘要
- 展望 2025
- Q & A
- 附件: 中砂願景, 核心技術及產品, 廠區資訊



中砂公司簡介

- 成立於1953年; 2005股票上市, TWSE 股票代號 1560
- 實收資本額 (2024/12/31): 新台幣 14.6億
- 員工人數: 全球 ~2100人. 台灣 ~1800人. 工廠: 台灣*5, 泰國*1
- 2024合併營收 70.2億 TWD, EPS=7.1
- 2024年三大事業部主要產品及佔總營收比率.

ABU 砂輪事業部(鶯歌廠)

+ 子公司: KTC(泰國), 鴻記(台灣)

營收佔比 18%



傳統磨料及鑽石砂輪
(機械與工具機業..)

DBU 鑽石事業部

(鶯歌&樹林&湖口廠)

32%

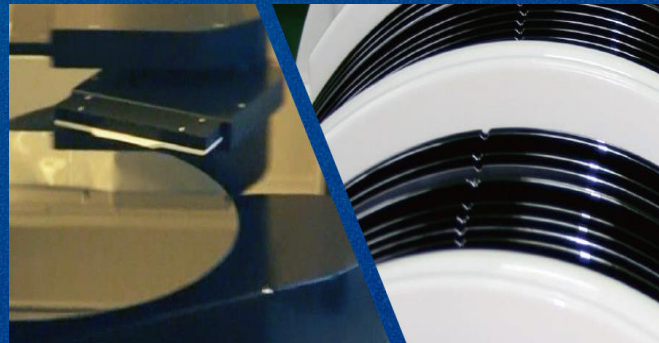


CMP 鑽石碟
(半導體業)

SBU 晶圓事業部

(竹北&竹南廠)

50%



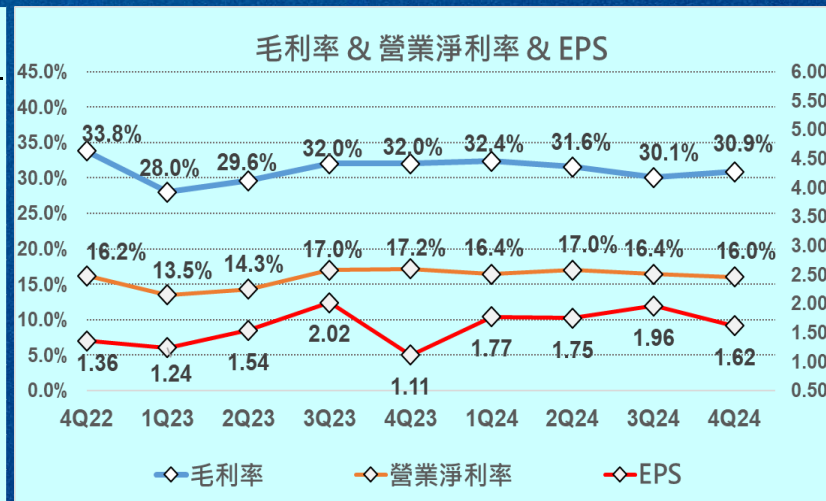
測試及再生矽晶圓
(半導體業)



2024 第四季營運概況 (合併財報)

- 4Q24合併營收 18.3億, QoQ -1.4%, 毛利率30.9%(+0.8 ppt), EPS=1.62
- 2024合併營收 70.2億, 較2023年 +10.0%, 毛利率31.2%(+0.7 ppt), EPS=7.1

Accounting Period Income (all in thousands TWD except *)	4Q24	3Q24	4Q24 over 3Q24	2024FY	2023FY	2024FY over 2023FY
*Net Revenue(USD thousand)	56,752	57,530	-1.4%	218,579	204,882	6.7%
Net Revenue	1,834,012	1,859,189	-1.4%	7,019,493	6,380,904	10.0%
Gross Margin	30.9%	30.1%	+0.8 ppt	31.2%	30.4%	+0.7 ppt
Operating Expenses	(272,181)	(253,353)	7.4%	(1,032,919)	(952,994)	8.4%
Operating Margin	16.0%	16.4%	-0.4 ppt	16.5%	15.5%	+1.0 ppt
Non-Operating Items	13,223	21,256	(8,033)	133,585	71,168	62,417
Net Income to Shareholders of the Parent Company	239,295	285,349	-16.1%	1,035,003	852,122	21.5%
Net Profit Margin	13.6%	15.3%	-1.7 ppt	15.1%	13.5%	+1.6 ppt
EPS	1.62	1.96	-17.3%	7.10	5.91	20.1%
ROE	14.3%	16.7%	-2.4 ppt	15.3%	13.7%	+1.6 ppt
Average Exchange Rate-USD/NTD	32.32	32.32	0.0%	32.12	31.14	3.1%





4Q24 各事業部及子公司營收

ABU: 砂輪事業部

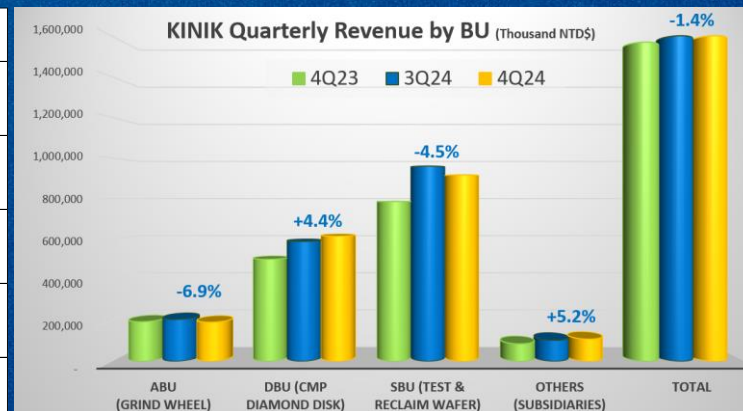
DBU: 鑽石事業部

SBU: 晶圓事業部

Others: 砂輪子公司

- 全公司: 第四季營收18.3億, QoQ -1.4%. 較2023第四季增加 16.9%.
- ABU: 傳產客戶需求下滑, 電子業客戶持平, 營收季減6.9%.
- DBU: 3奈米及2奈米先進製程之鑽石碟出貨增加, 營收季增 4.4%
- SBU: 12" 測試晶圓出貨減少, 營收季減 -4.5%

Business Unit	4Q23	3Q24	4Q24		QoQ	YoY
ABU (Grind Wheel)	194,905	206,463	192,291	10%	-6.9%	-1.3%
DBU (CMP Diamond Disk)	501,685	589,715	615,474	34%	4.4%	22.7%
SBU (Test & Reclaim Wafer)	785,569	959,557	916,527	50%	-4.5%	16.7%
Others (Subsidiaries)	86,414	103,864	109,313	6%	5.2%	26.5%
Total	1,568,572	1,859,597	1,833,604	100%	-1.40%	16.9%





2024全年 各事業部及子公司營收

ABU: 砂輪事業部

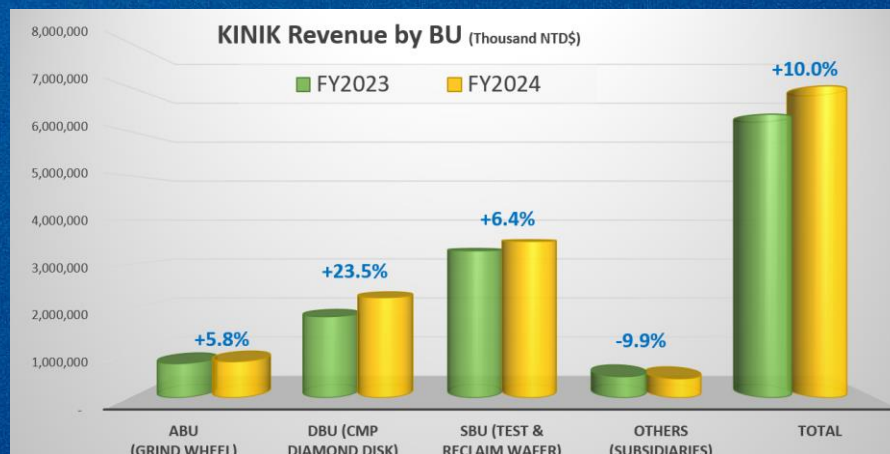
DBU: 鑽石事業部

SBU: 晶圓事業部

Others: 砂輪子公司

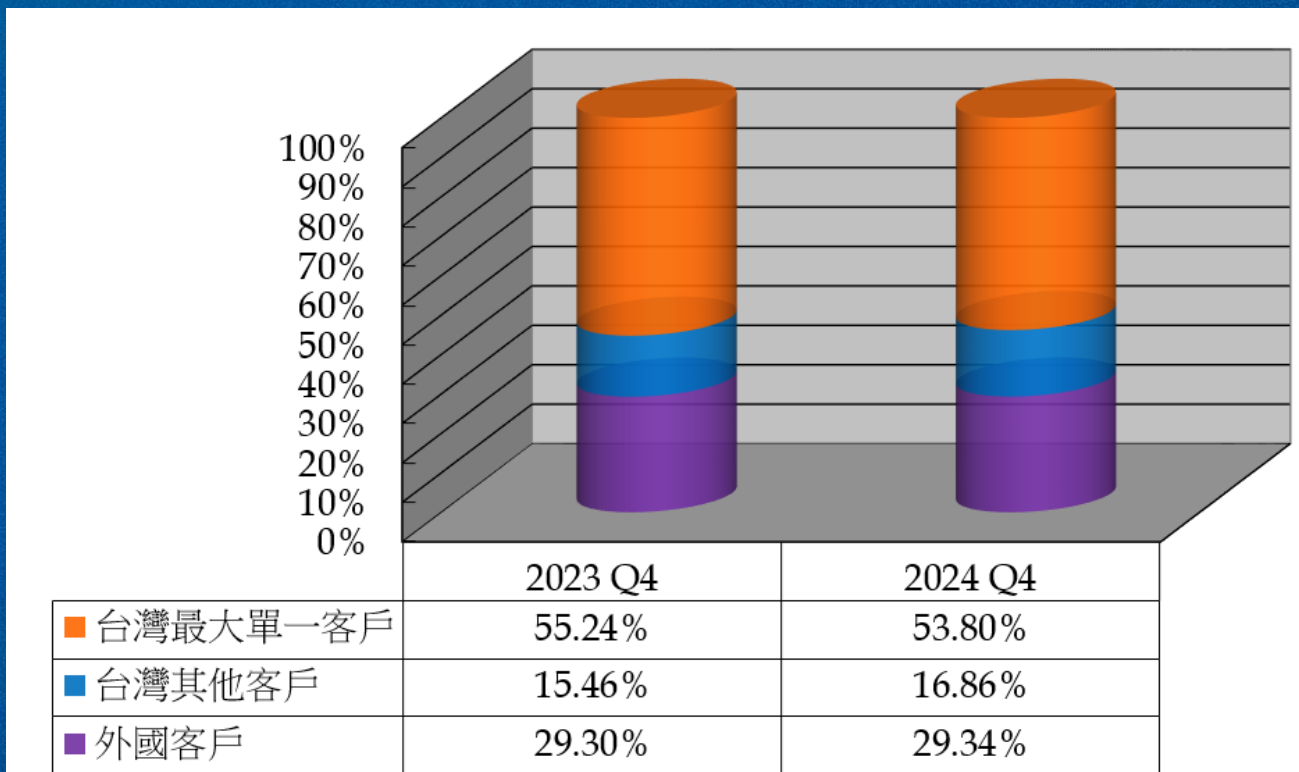
- 全公司: 2024營收 YoY +10.0%.
- 其中以 DBU鑽石碟營收+23%最高，在全公司營收占比由29%上升至32%。

Business Unit	FY2023	FY2024		YoY
ABU (Grind Wheel)	769,149	813,760	12%	5.8%
DBU (CMP Diamond Disk)	1,825,729	2,254,073	32%	23.5%
SBU (Test & Reclaim Wafer)	3,308,944	3,521,695	50%	6.4%
Others (Subsidiaries)	477,083	429,965	6%	-9.9%
Total	6,380,904	7,019,494	100%	10.0%



4Q24 鑽石碟營收表現(1/2)

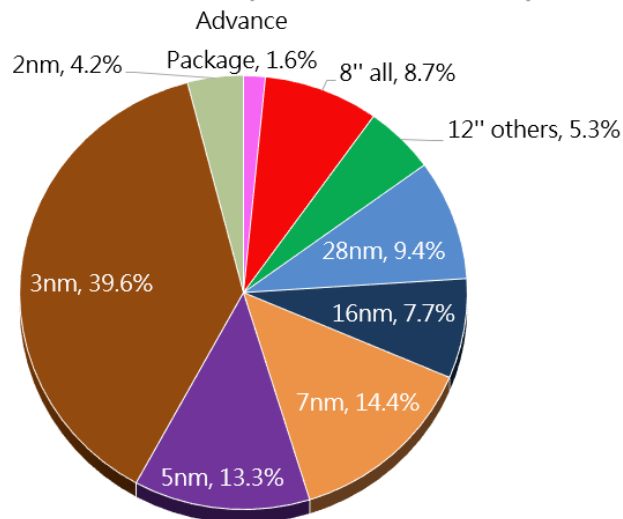
國內外客戶鑽石碟營收百分比



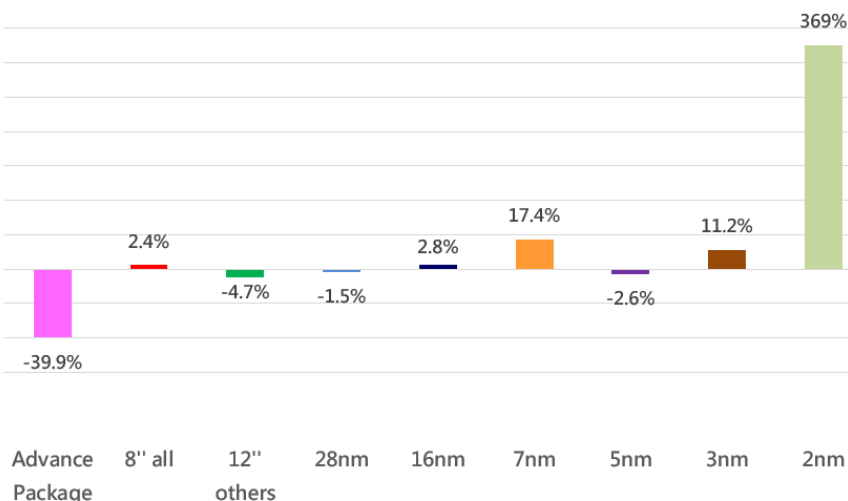
4Q24 鑽石碟營收表現(2/2)

- 4Q24 DBU 營收QoQ +4.4%.
- 先進製程產品(5奈米以下)營收占比由上一季52.6%增加至57.1%，主要來自是3nm及2nm的鑽石碟出貨增加。

4Q24 鑽石碟銷售比例 (@台灣單一最大客戶)



4Q24 鑽石碟銷售金額季增減%



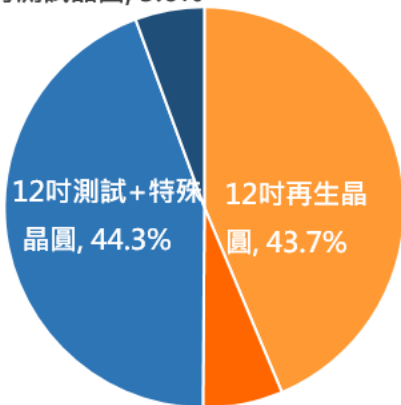
備註：資料對象為國內單一最大客戶。

4Q24 晶圓事業部產品別分析

- 12" 測試晶圓出貨減少，營收季減 -4.5%

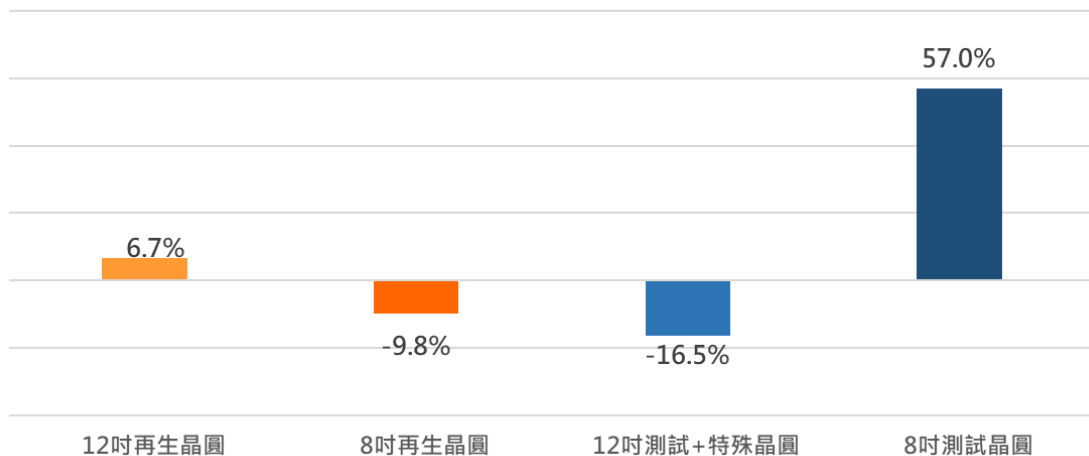
4Q24 晶圓事業部產品營收比例

8吋測試晶圓, 5.6%



8吋再生晶圓, 6.5%

4Q24晶圓銷售季增減%



近期重要事件摘要

- 2024年12月24日中砂董事會通過，增加20億元資本支出用於擴增10萬片產能，於SBU竹南廠第二期之12吋矽晶圓生產設備，2026年下半年起之12吋總產能將由目前的30萬片增加至40萬片。
- 2025年1月22日董事會決議，為切入日本與強化東南亞市場，開創更多成長機會，與日本三井金屬鑛業集團簽訂正式收購協議：收購日本三井金屬鑛業集團旗下位於日本的「三井研削砥石株式會社」(簡稱MKS) 100%股權，收購金額為19.19 億日圓、中砂與子公司 KINIK Thai Company Limited共同收購日本三井金屬鑛業集團位於泰國的「Mitsui Grinding Technology (Thailand)Co., Ltd.」簡稱 MGT)，收購金額為 4.5 億泰銖 (THB)；二家公司收購總金額相當於新台幣8.36億元。

新聞稿



◆ ABU 砂輪事業部:

- 2025傳產機械工具機客戶需求將緩步回升，加上高階砂輪以及ABF客戶數與需求增加，ABU全年將較2024營收小幅成長。

◆ DBU 鑽石事業部

- 邏輯先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟持續成長，且2奈米用之鑽石碟將逐季增加。
- 2024年單月最高出貨到達四萬顆，2024年底已完成產能增加至五萬顆，以滿足客戶2025年之可能需求。

◆ SBU 晶圓事業部：

- 再生及測試晶圓平均單價將與2024持平，2025年第三季起總產能將增加3萬片至33萬片12吋產能。
- 持續增加高階產品組合及特殊晶圓比重，將持續提升營收與毛利。

Q & A

報告完畢
敬請指教

中砂投資人服務信箱
ir@kinik.com.tw

- 中國砂輪企業股份有限公司 中砂 為切入日本與強化東南亞市場，開創更多成長機會，於今日114年1月22日董事會決議與日本三井金屬鑛業集團 (Mitsui Mining & Smelting Ltd.) 簽訂正式收購協議：收購日本三井金屬鑛業集團旗下位於日本的「三井研削砥石株式會社」(Mitsui Grinding Wheel Co., Ltd. 簡稱 MKS) 100%股權，收購金額為19.19 億日圓，中砂與子公司 KINIK Thai Company Limited共同收購日本三井金屬鑛業集團位於泰國的「Mitsui Grinding Technology (Thailand) Co., Ltd. 簡稱 MGT) (MGT)」，收購金額為 4.5 億泰銖 (THB)；二家公司收購總金額相當於新台幣8.36 億元。
- 中砂是國內第一家砂輪廠，創立於1953年，從傳統砂輪製造起家，隨台灣工業的發展延伸至光電、半導體用的鑽石砂輪產品，在《精益求精為產業與客戶創新價值》的使命驅使下，在2000年開始將砂輪製造技術延伸至半導體用鑽石碟、將砂輪研磨技術運用到半導體矽晶圓的再生產業，並發展半導體級的真空吸盤與晶粒切割刀具，可以完整地提供半導體產業高端市場的需求，提升了產品的附加價值，已成為全世界半導體上、中、下游產業在研磨相關製程上不可或缺的治工具與耗材的重要夥伴。「三井研削砥石株式會社」(MKS) 於 1923 年轉入「三井金屬鑛業株式會社」的前身「三井鑛山株式會社」從事砂輪製造與銷售迄今已超過102年，主要生產中大型精密零件及超級磨料砂輪，提供日本國內汽車、螺桿與精密零組件等加工所需。另外該集團於1994年亦在泰國成立「Mitsui Grinding Technology (Co., Ltd.)」(MGT 公司) 專精於無心研磨砂輪、DSG 雙平面研磨及大型傳統砂輪的生產和市場佈局，在東南亞就近服務客戶並回銷日本，兩家砂輪公司在日本與東南亞市場均有舉足輕重的地位。砂輪在精密研磨與半導體材料研磨上，均扮演非常重要的角色。且中砂與三井金屬鑛業集團的合作關係早在 1967 年就有過十年的技術合作經驗之後中砂長期派人至日本三井學習相關技術，其後雙方也陸續都有生意上的來往，高層並保持友好密切的關係。此次透過昔日師生的合體，加上以電鍍產品為主的中砂子公司鴻記工業，中砂集團旗下將擁有橫跨日本、台灣及泰國共五家砂輪廠，產品線將越臻完整，再加上原有的鑽石碟與再生晶圓服務，預期將可強化其在研磨領域的競爭力。透過本次強強結合與技術的整合，將有效提升中砂集團的技術與產品的完整性，並可藉由新的通路強化與擴大日本與東南亞地區的行銷範圍及網絡服務更多的客戶，為中砂開創更多成長機會！

附件

- ◆ 中砂經營理念
- ◆ 中砂產品介紹
- ◆ 各廠區資訊
- ◆ 榮耀記事



企業經營理念使命與願景

Business philosophy
Good together

Good to You, Me, All

經營
理念
共
好

你好，我好，大家好

使
命

Mission

Keep creating innovative values
for industries and customers.

精益求精為產業
與客戶創新價值

Vision

願
景

成為研磨解決方案的
卓越智造與服務中心

Become an excellent and intelligent
smart manufacturing and service center
for grinding solutions.

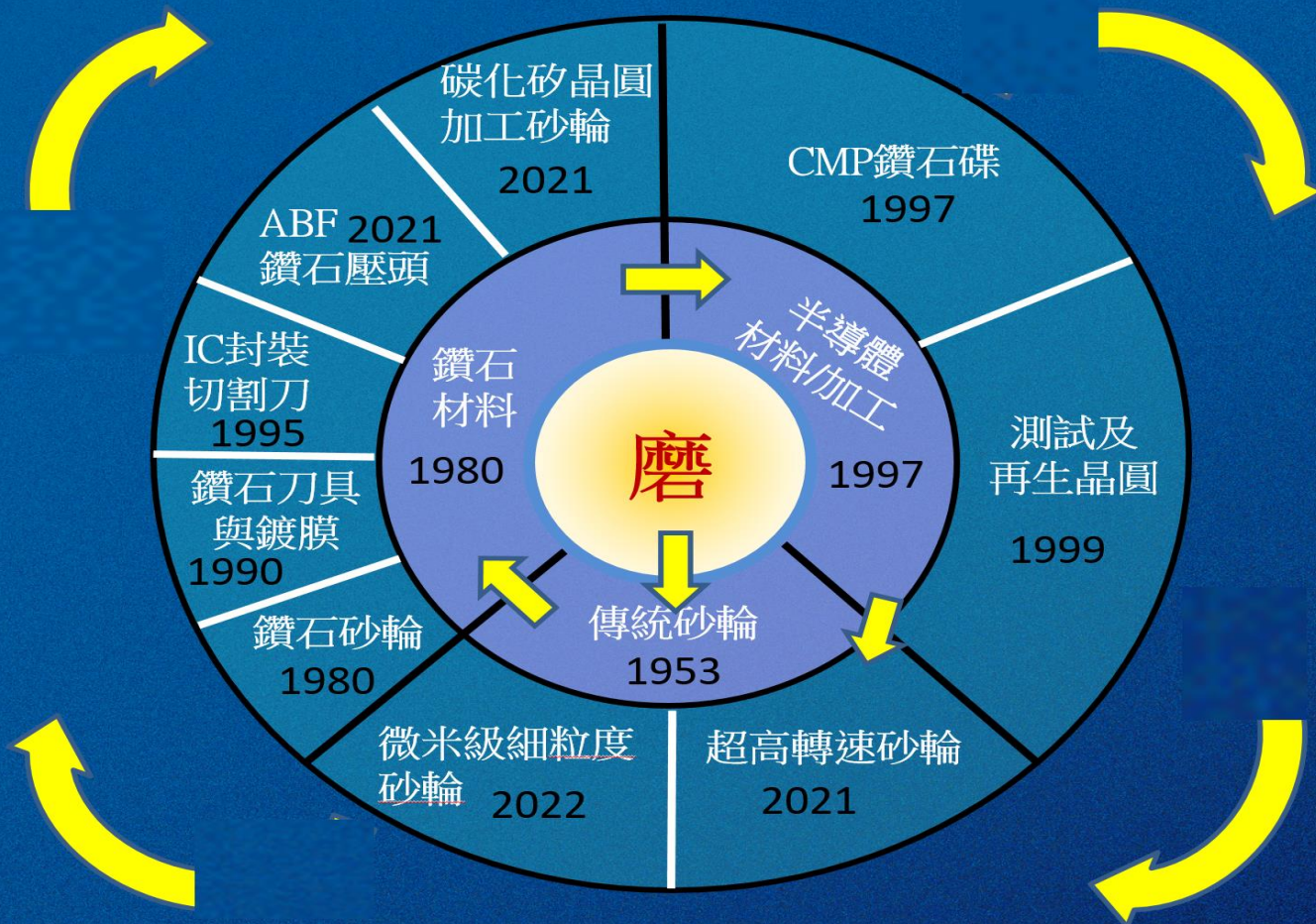


從磨石頭到磨半導體 中砂的70年成長之路與未來展望



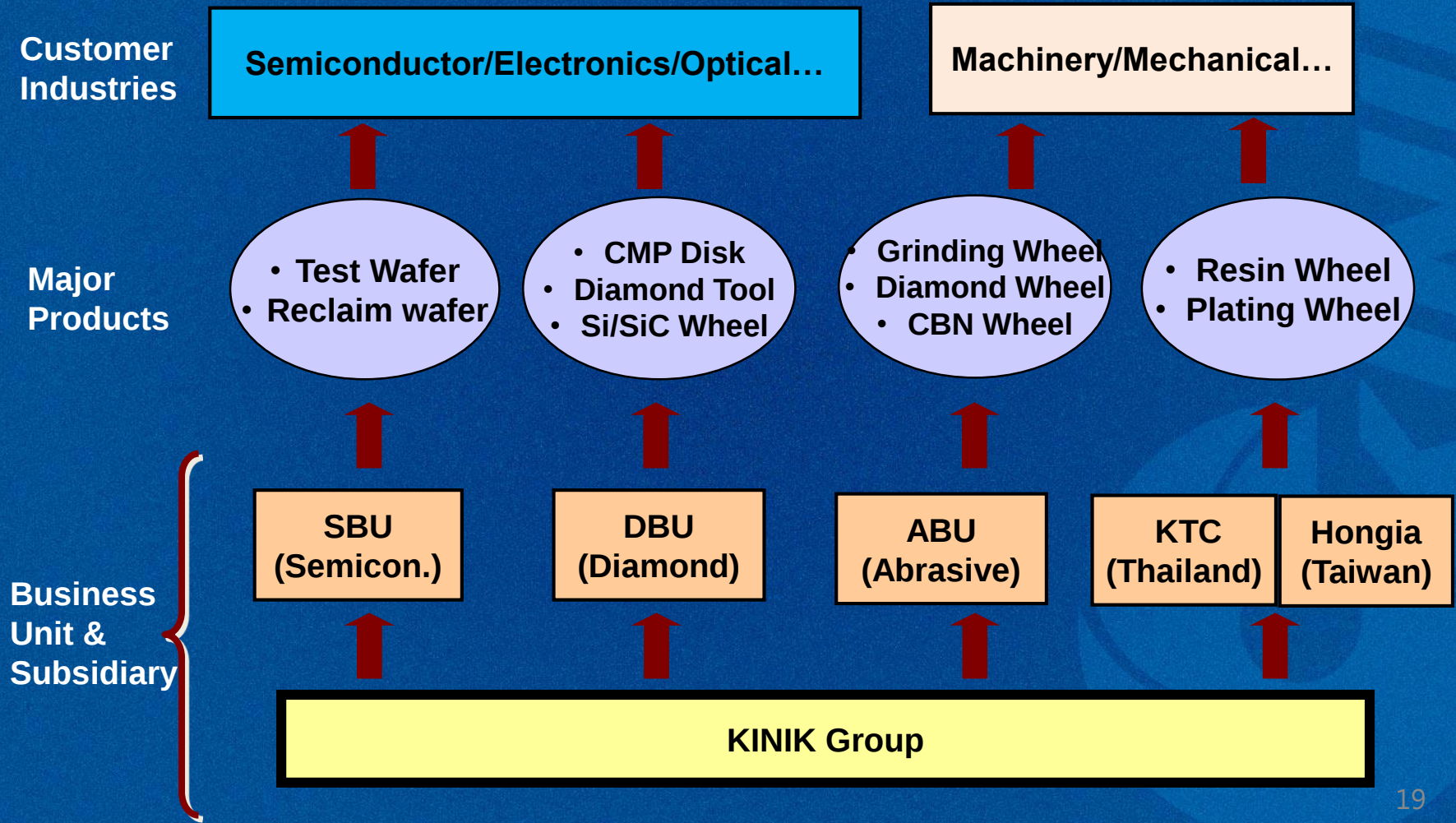


以「磨」為核心提供各產業所需產品



循著砂輪的旋轉軌跡不斷前進

Major Product and Business Diagram



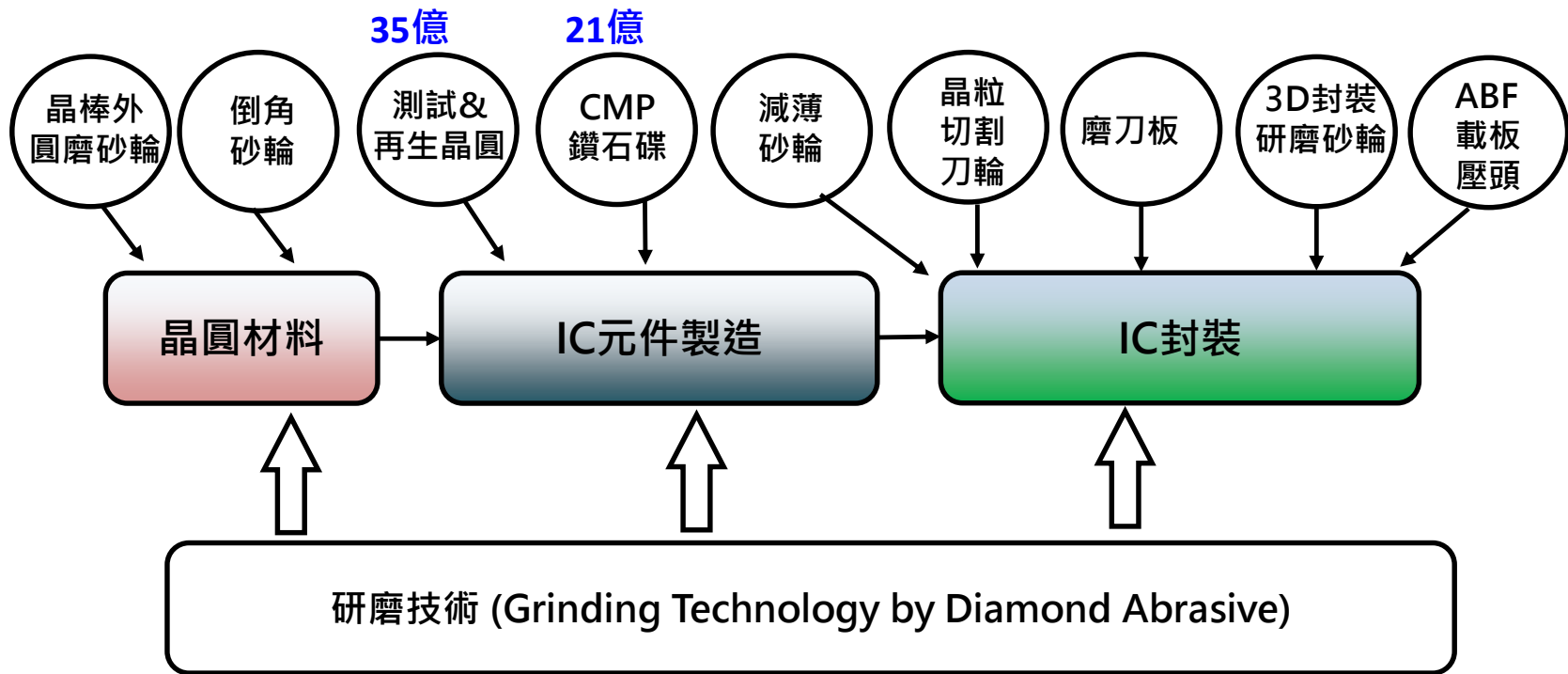


中砂產品介紹

Products Introduction

中砂研磨產品在半導體製程的角色

2024年營收新台幣



2024年中砂在半導體相關產業的營收58億元，佔KINIK合併營收約82%，
且毛利率34%(3%高於2024全部產品的平均31%)

What is test and reclaim wafer?

The source of the reclaimed wafers comes from the monitor wafers and the dummy wafers but not the defect wafers manufactured by the semiconductor fab. The services we provide to refurbish these reclaimed wafers can dramatically lower the running cost of a semiconductor manufacturer.

The reclaimed wafers can be categorized according to functions as figure 1 and the reclamation system is shown as figure 2.

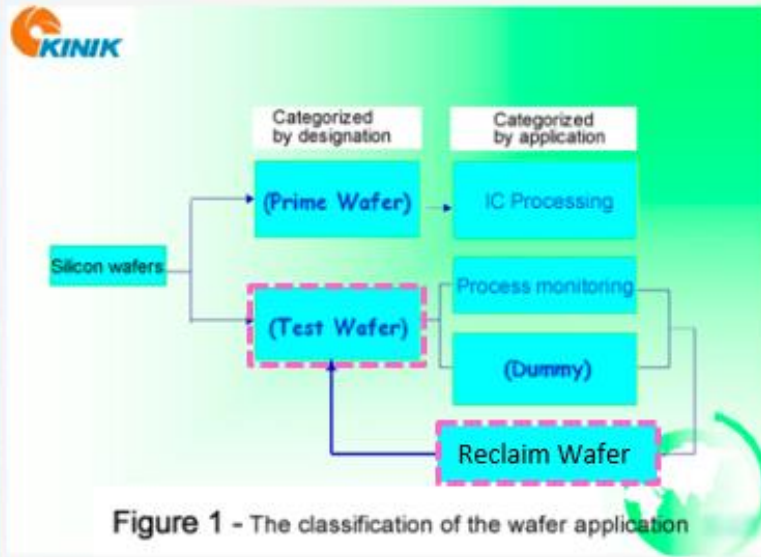


Figure 1 - The classification of the wafer application

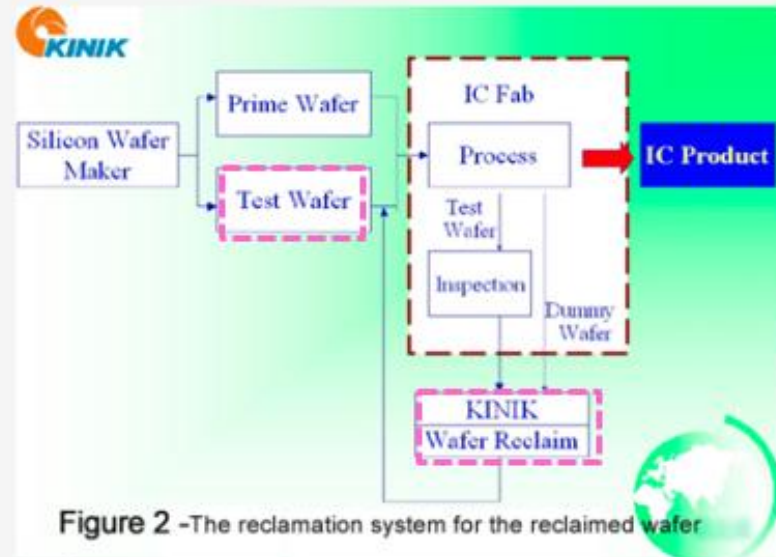


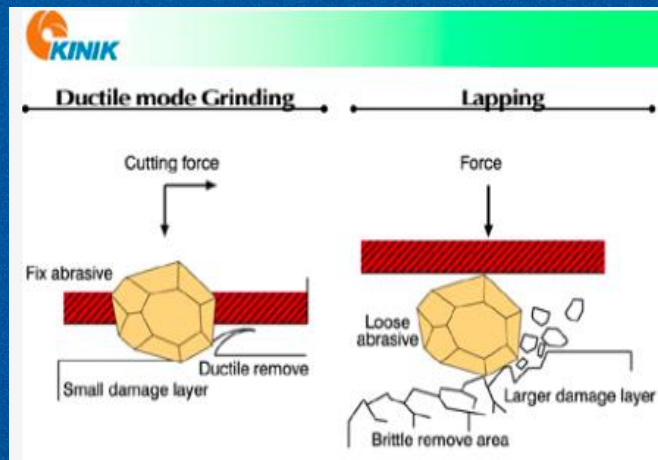
Figure 2 -The reclamation system for the reclaimed wafer



測試/再生晶圓 Test/Reclaim Wafer

中砂的測試與再生晶圓之製程特色以延性輪磨(Ductile Mode Grinding)加工取代傳統研磨(Lapping)加工，目的是降低加工之變質層，減少化學藥品污染，且可提高加工精度，為最先進之再生晶圓製程。

The features of the KINIK's test and reclaimed wafers are processed by ductile mode grinding used to replace traditional lapping to lower the damaged thickness on the surface and for less chemical contamination. The ductile mode grinding is the leading-edge process for the high precious reclaimed wafers.

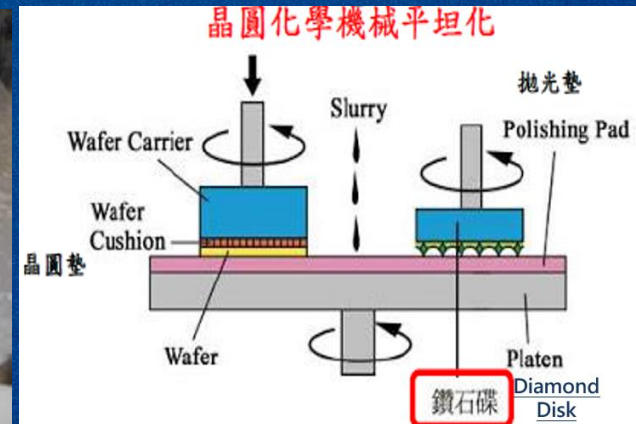
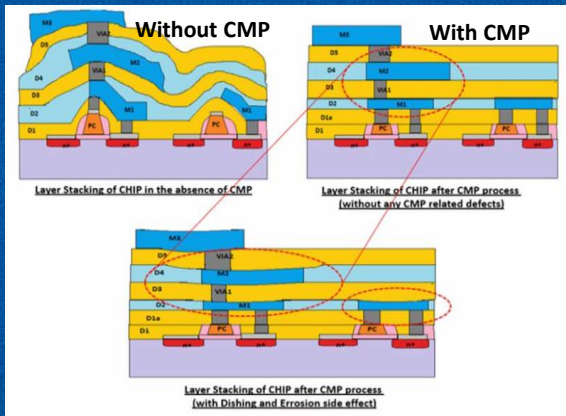




CMP 鑽石碟 Diamond Disk

CMP (Chemical Mechanical Polish) 化學機械拋光，主要用於先進IC製程中，透過拋光墊與拋光液同時透過機械與化學反應加工晶圓表面，達到表面晶圓材料的移除及整體的平坦化，才能接續後續製程以及提高良率，進而能循摩爾定律持續微縮IC線寬面積，推展出N5/N3/N2先進製程。而**鑽石碟**的功用就是在拋光晶圓的同時去加工拋光墊，以移除拋光時的副產物及穩定拋光速率並提升良率及延長拋光墊使用壽命，是先進IC拋光製程中提升良率及控制成本中非常重要的一環。

CMP (Chemical Mechanical Polish) is widely used for advanced IC manufacturing processes for surface material removal, smoothing surfaces, and planarization by the polish pad (mechanical) and the abrasive slurry (chemical reaction). And the **diamond disk (aka pad conditioner)**'s function is to in-situ dress the polish pad during the process to remove the polish byproduct, to maintain a stable pad roughness and remove rate, to improve yield, and to prolong the lifetime of the pad.





CMP 鑽石碟 Diamond Disk

中砂鑽石碟用於半導體化學機械研磨製程中修整研磨墊以達到理想移除率及平坦度。

KINIK diamond disk is used on semi-conductor CMP process in order to make the pad reach the desirable removal rate and uniformity.

Conventional Disk



DiaGrid®

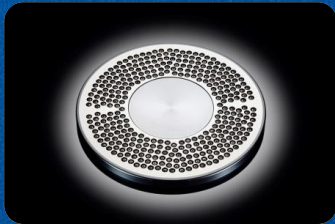


I-DiaGrid®



S-DiaGrid®

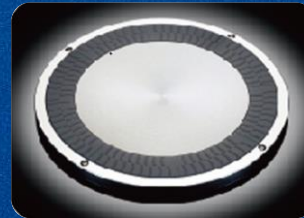
Advanced Disk : High Performance / Long Life Time



Pyradia®



EDP Disk
(Metal Free)



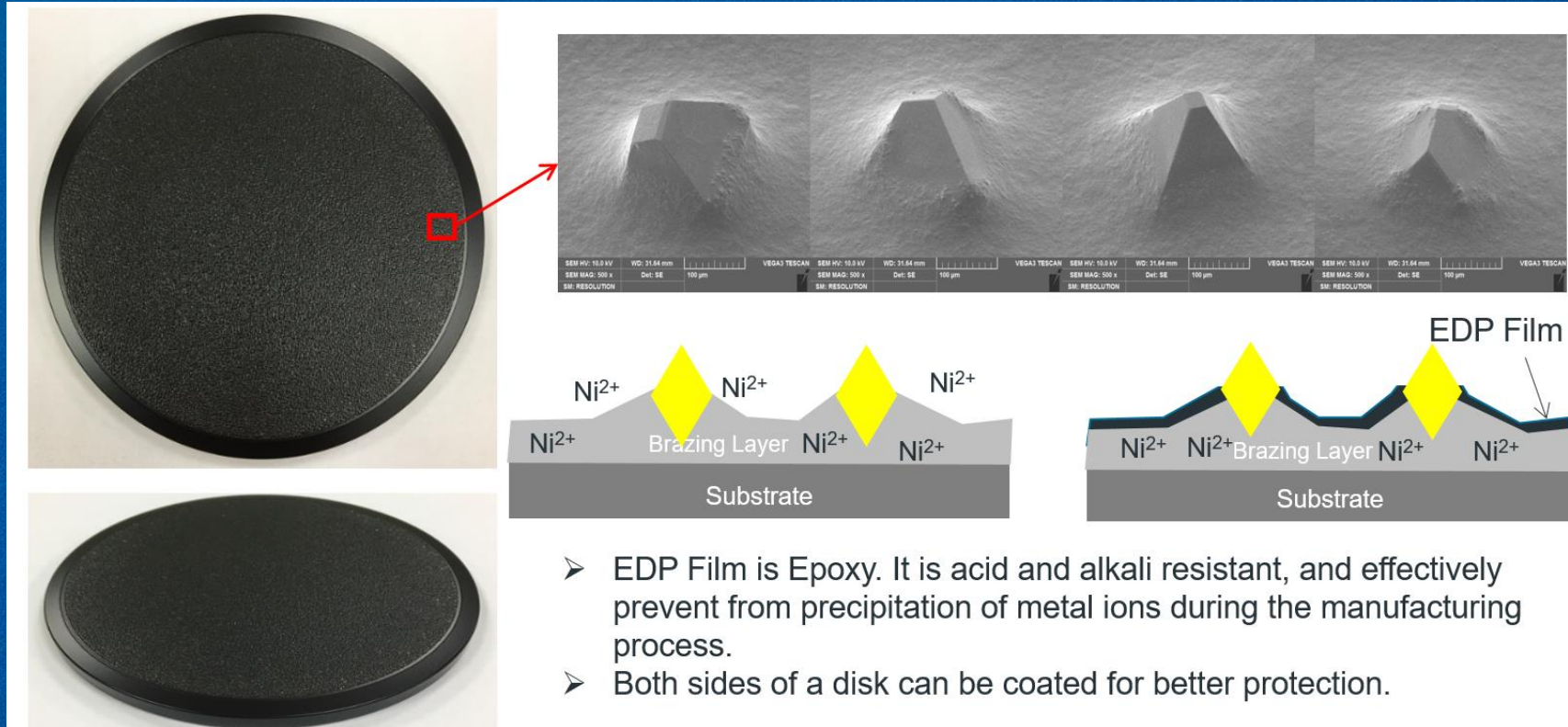
CVD -WAVE®



equaDia®

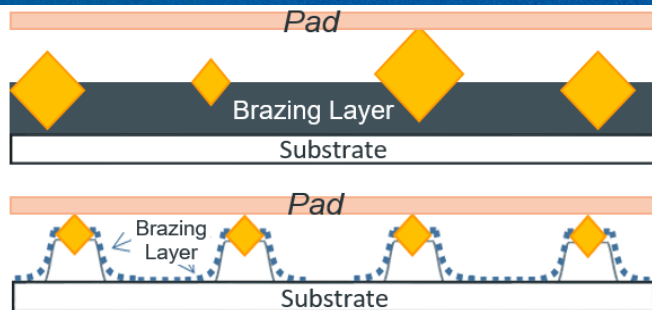
EDP Disk for Metal Free Solution

- Diamond disk protected with EDP film for metal-free requested in advanced IC technologies.

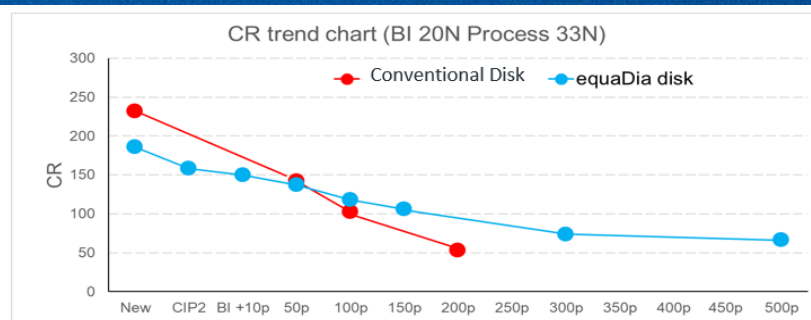


- EDP Film is Epoxy. It is acid and alkali resistant, and effectively prevent from precipitation of metal ions during the manufacturing process.
- Both sides of a disk can be coated for better protection.

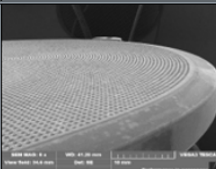
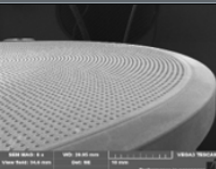
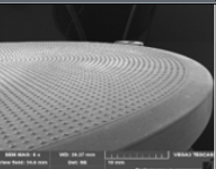
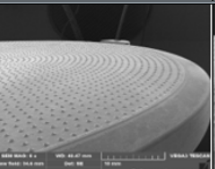
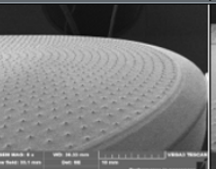
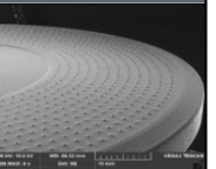
- Advanced disk “equaDia” for excellence tip height leveling and longer lifetime.



- Conventional Disk dressed a pad with the high points of the diamond. equaDia disk has good diamond leveling, and each diamond works. CR decay of equaDia disk is much slower.



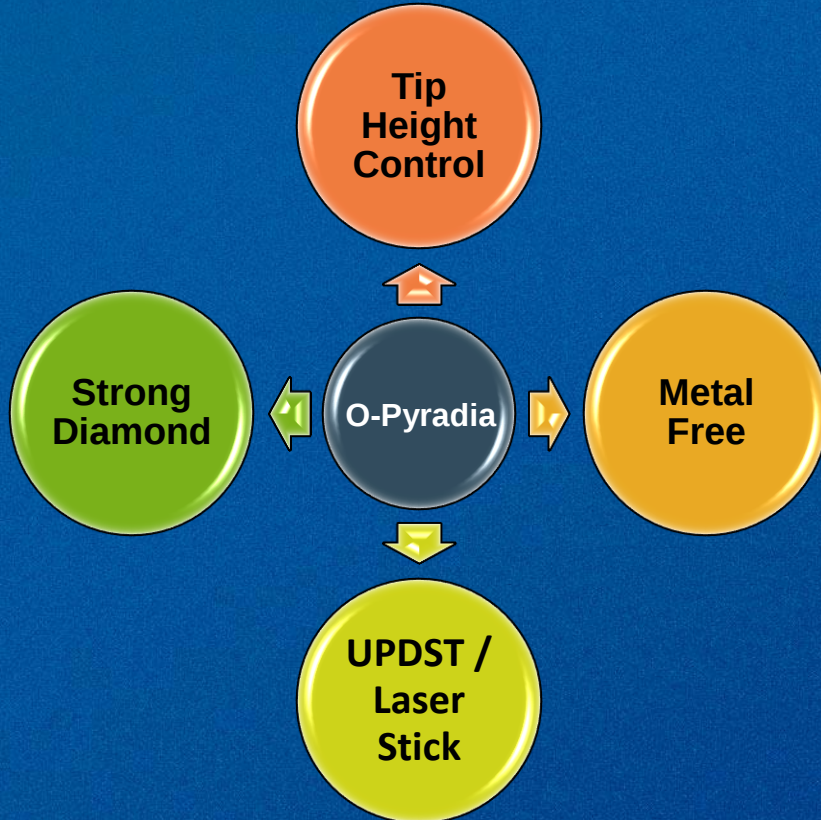
CR decay rate	100p	200p	300p	500p
Conventional Disk	56%	77%	-	-
equaDia disk	25%	-	54%	58%

	equaDia P800	equaDia P1000	equaDia P1200	equaDia P1500	equaDia P2000	equaDia P2000
SEM						
Appearance	Full face	Full face	Full face	Full face	Full face	Donut type
Diamond Size (μm)	100	100	100	100	170	170
Diamond pitch (μm)	800	1000	1200	1500	2000	2000
Diamond Bonded (%)	55%	53%	56%	51%	53%	55%
Leveling (μm)	6.9	7.2	7.6	6.7	9.7	9.9
total diamond count (ea)	11600	7450	5200	3350	1900	1400



Metal-free O-Pyradia® 鑽石碟

- O-Pyradia CMP pad conditioner for advanced customer's tightened metal contamination control.



Pyradia Type	O-Pyradia	Pyradia
Photo		
Material of Substrate	Polymer	Metal
Bonding Material	Polymer	LM(Ni ; Cr powder)
Bonding Strength	+	++
Process Temp	<100 degree	~1000 degree
Diamond Strength	++	+
Acid and alkali resistant	Metal Free	Ni ; Cr

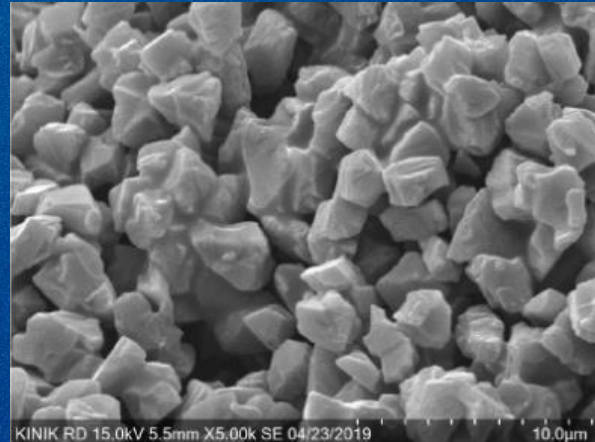


Wafer Grinding Wheel

- 中砂的晶圓研磨砂輪可用於矽晶圓加工、IC封裝(WLP/PLP/2.5D/3D)、碳化矽、藍寶石及再生晶圓等硬脆材料的直立式進給研磨加工應用。直立式進給的晶圓研磨加工一般包括粗及細研磨製程，可依客戶加工需求，來客製化設計陶瓷結合劑，鑽石磨料及微結構組織。晶圓研磨砂輪的鑽石粒度一般為#325 ~ #1000及#2000 ~ #8000。其特色為有穩定的高材料移除率、長效使用壽命及低研磨阻抗電流等優點。



晶圓研磨砂輪



孔隙微結構組織

鑽石滾輪

- 鑽石滾輪乃應用於複雜形狀且高精度之成形研磨砂輪的修整(例如氧化鋁, 碳化矽, 氮化硼cBN砂輪), 適用於例如滾珠螺桿、滑軌、軸承、齒輪、刀治具、汽車及航太零件等產業之精密元件, 於成形或創成批量產研磨加工時維持砂輪形狀精度的自動化修整作業。
- 鑽石滾輪是利用天然/人造或CVD鑽石, 以反轉電鑄或滲透燒結等製法來製作而成, 鑽石採隨機或規則性的排列, 具有高形狀精度及高修整效率等特色, 我們可依客戶需求提供適用於各式不同磨床機台與成形研磨加工應用的各製法鑽石修整滾輪。



滾珠螺桿成形砂輪修整用鑽石滾輪



半導體及光電業工具

Semiconductor & photoelectric Tool

中砂以最新電鑄、成型與燒結技術製造成的精密鑽石切割刀。搭配特殊的金屬與樹脂等結合劑，使切割軟刀具備高剛性、低磨耗且具備良好的自銳性；適合在各類精密陶瓷、硬脆材料、磁性材料，光學玻璃，印刷電路板與半導體封裝材料的切割應用。

KINIK Company announces the introduction of Super Hubless Dicing Blade with resin, metal and nickel matrices. The dicing blades are manufactured by specialty consolidation, sintering and electro-forming process that improve the uniformity of the thin blades. They are suitable for cutting ceramics, brittle materials, optical glass, printed circuit boards, especially for semiconductor packaging.



鑽石切割軟刀 Dicing Blade



磨刀板 Dressing Board



半導體及光電業工具

Semiconductor & photoelectric Tool

多孔質陶瓷真空吸盤

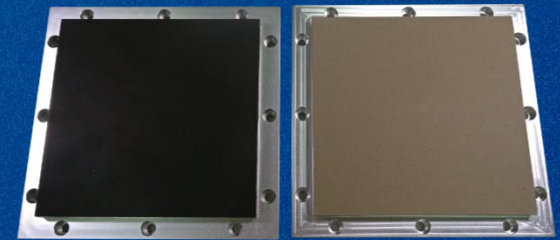
Porous Ceramic Chuck Table

多孔質陶瓷孔洞均勻微細、不發塵、可具靜電消散特性，應用於真空吸盤具備吸力均勻、局部吸附性、不產生印痕、工作效率及精度高等優點，可充分應用於半導體研磨、清洗、切割及檢測等設備。

- High-performance, High-precision, Uniform suction force.
- Partial chucking without sagging.
- Chucking and transport of wafer without leaving suction marks.
- Produces no static electricity and dust.

Application :

Wafer grinder, cleaning/dicing machine and measuring equipment, etc.





精密加工PCD刀具

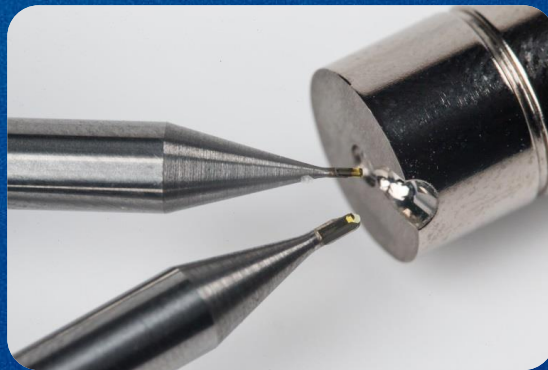
Ultra Precision Machining Tools

中砂提供電子業、PCB板、木工業及金屬加工業所需的單晶（SCD）、聚晶鑽（PCD）、立方氮化硼（PcBN）等鑽石刀具已逾20年。

近年積極投入生產高精度、更微小之SCD、PCD 及 PcBN產品供光學業、精密模具等加工技術使用，如：單晶鑽石車刀與銑刀、PcBN微小徑銑刀等。

KINIK company already has more than 20-year experience in providing all kinds of diamond tools for the applications of PCB, woodworking and metal working industries.

Recently, KINIK also developed several kinds of SCD, PCD and PcBN precision micro tools to meet high-end market's requirements.



加工面達到極高的光潔度表現。
High finish at processing parts.



PVD/CVD 鍍膜

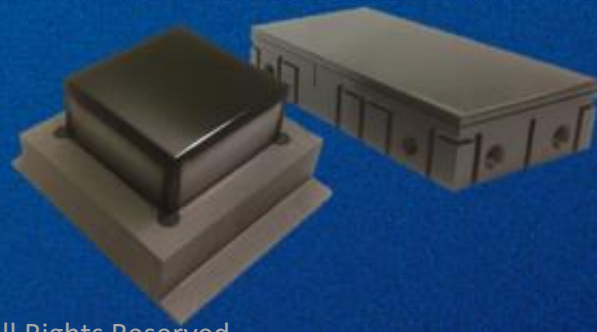
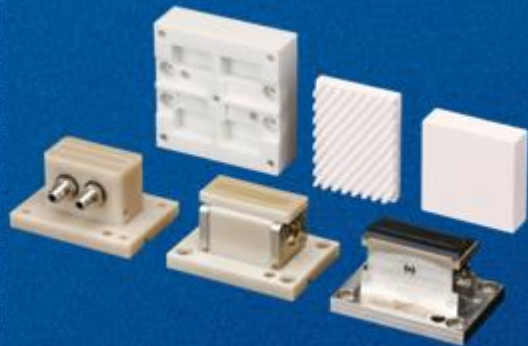
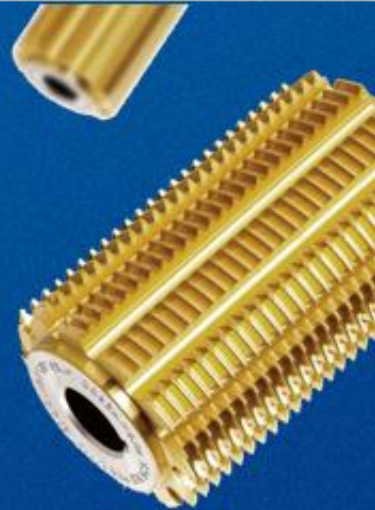
PVD/CVD Coating Service

中砂鍍膜代工中心2000年成立，在PVD/CVD真空鍍膜領域深耕近20年，不斷投入相關鍍膜設備及開發TiN、TiCN、TiAlN、DLC、Diamond鍍膜技術等。同時持續將研究成果應用至各個產業，提供給客戶高效能的鍍膜應用工具，包括機械加工、精密模具、3C產品、汽車、通訊、醫療、光學及電子產業等。

Established in 2000, KINIK Coating Center has 20 years of experiences in PVD/CVD coating.

KINIK persistently invests in the development of PVD/CVD equipment and coating technologies of TiN, TiCN, TiAlN, DLC and Diamond etc.

KINIK provides these high-performance, hard films coated tools for customers in various industrial applications, including machining tools, precision molds, 3C products, automobiles, communication, medical, optical, electronics and so on.





傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel

中砂提供各式平面、內外圓、無心及雙平面等工件研磨及切斷用的傳統、BD及電鑄砂輪。

主要產業應用包含精密機械業的滑軌及齒輪研磨與砂輪成形修整用的鑽石滾輪、鋼鐵業的軋筒研磨、工具製造業的高速鋼鑽頭、CNC及PCD/PcBN刀具等研磨、半導體業的晶圓減薄及倒角研磨、高效率硬脆材料如SiC研磨用的蜂巢砂輪、光學模具模仁拋光等。

KINIK provides various grinding wheels for surface, internal & cylindrical, centerless and disc surface grinding and cutting of workpiece production. The main industrial applications include linear guideway, gear grinding and diamond roller for dressing wheel in precision machinery, steel roll grinding, HSS drill, CNC & PCD/PcBN tool grinding, wafer thinning and edge grinding in semiconductor, honeycomb wheel for high-efficient grinding of hard and brittle materials such as SiC, optical mold polishing etc.

傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel



平面研磨
Surface Grinding



外圓研磨
Cylindrical Grinding



輥筒研磨
Roll Grinding



滑軌成形研磨
Linear Guideway Grinding



雙平面研磨
Disc Surface Grinding



齒輪研磨
Gear Grinding



傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel



光學模仁拋光
Optical Mold Polishing



內圓研磨
Internal Grinding



CNC刀具研磨
CNC Tools Grinding



蜂巢砂輪
Diamond & CBN Honey Comb Wheel



PCD刀具研磨
PCD Cutting Tools Grinding



傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel



電鑄砂輪
Electroplated Diamond & CBN Wheels
and Products



各式切斷及可彎曲、碟式砂輪
Cut-off, Depressed & Flexible Wheels, and
Flap Disc



鑽石滾輪
Diamond Roller



砂輪動平衡校正儀
Grinder Balancer



廠區 Plant



總公司 Head Office 鶯歌廠區 Yingge Factory

239010 新北市鶯歌區中山路64號
No.64, Zhongshan Rd., Yingge Dist.,
New Taipei City 239010, Taiwan
TEL:+886 2 2679-1931~40

Grinding Wheel & Diamond Disk



樹林廠區 Shulin Factory

238010 新北市樹林區中山路2段151巷16號
No.16, Ln. 151, Sec. 2, Zhongshan Rd.,
Shulin Dist., New Taipei City 238010, Taiwan
TEL:+886 2 8684-4111~13

Diamond Disk
Diamond Cutting & Dicing Tools



新竹廠區 Hsinchu Factory

303035 新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路6號
No.6, Wenhua Rd., Hukou, Hsinchu Ind.
Park, Hsinchu County 303035, Taiwan
TEL:+886 3 598-4990

Diamond Dicing Tools. PVD Coating
Ceramic Vacuum Chuck



廠區 Plant



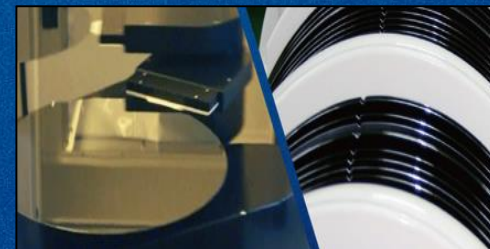
竹北廠區 Zhubei Factory

302059 新竹縣竹北市十興路260號
No.260, Shixing Rd., Zhubei City,
Hsinchu County 302059, Taiwan
TEL:+886 3 550-7160~5



竹科廠區 Hsinchu Science Park Factory

350401 苗栗縣竹南鎮科北五路6號
No. 6, Kebei 5th Rd., Jhunan
Township, Miaoli County 350401,
Taiwan
TEL:+886 3 550-7160



Reclaim & Test Wafer
再生晶圓 & 測試晶圓



廠區 Plant



鴻記工業股份有限公司

Hongia Industry Co, Ltd.

239008 新北市鶯歌區余厝巷2號

No. 2, Yucho Lane, Yingge Dist.,

New Taipei City 239008, Taiwan

TEL:+886 2 2679-1006

Email : hongia-sale@kinik.com.tw

www.hongia.com.tw



Electroplated Diamond
Wheel 電鑄砂輪



金力泰國有限公司

Kinik - Thai Co., Ltd.

225 Moo 7, Khok Pip, Simahosot,

Prachinburi 25190 Thailand

TEL:+663 727 6954

Email : sales@kinikthai.co.th

www.kinikthai.co.th



Resin and Ceramic Wheel
樹脂砂輪&陶瓷砂輪

榮耀記事 Milestone



2021年11月榮獲行政院「第26屆國家品質獎 全面卓越類 - 績優經營獎」。

Nov. 2021, Honored with "BUSINESS MERIT AWARD of Total BUSINESS EXCELLENCE" at the 26th NATIONAL QUALITY AWARD from the Executive Yuan, R.O.C.

https://nqa.cpc.tw/NQA/Web/Awards26th_Content.aspx?p=f2b6e812-92aa-49c3-8149-1e005a0fe706

賀!中國砂輪公司榮獲「第26屆國家品質獎」



經濟部 林全能次長(左)、中國砂輪公司 林伯全董事長(右)。圖/經濟部工業局提供。

中國砂輪公司 榮獲「第26屆國家品質獎」，林伯全董事長受邀晉見總統



中國砂輪公司董事長 林伯全(右)、總統 蔡英文(左)。圖/總統府提供



2021年10月榮獲經濟部「2022年第30屆台灣精品獎 - 12吋再生晶圓」。

Oct. 2021, Honored with "Taiwan Excellence Award - 12" Reclaimed Wafers" from the MOEA, R.O.C.

<https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/product/1110433>



TAIWAN EXCELLENCE

得獎產品：12 inches Reclaim Wafer



榮獲經濟部第四屆卓越中堅企業獎

Honored with 4th Taiwan mittelstand Award from the MOEA, R.O.C, in 2017.



榮獲經濟部2013年 第14屆 工業精銳獎 機械、運輸工業類

Honored with 14th Industrial Sustainable Excellence Award from the MOEA, R.O.C, in 2013.

TOP 100
TAIWAN BRANDS



榮獲經濟部台灣百大品牌獎

Honored with the Top 100 Taiwan Brands Award from the MOEA, R.O.C, in 2011.



榮獲經濟部2006年台灣優良品牌獎

Honored with the Taiwan Superior Brand Award from the MOEA, R.O.C, in 2006.



榮獲第十屆經濟部產業科技發展傑出獎

Award of Excellence, the 10th R.O.C. MOEA Industrial Technology Advancement Award in 2002.



全國第一家砂輪公司榮獲國家傑出精品獎

The first grinding wheel plant won Excellent Product Award in 1993.